

公差配合与技术测量

作者：封金祥，胡建国主编；武兴睿，乔振华，车永明，孙秀艳，邹津婷，任辉副主编

出版社：北京：北京理工大学出版社

出版日期：2016.06

总页数：238

介绍：全书共十章，分别是绪论、极限与配合基础、技术测量基础、几何公差与检测、表面粗糙度

说明：登录教客网(<https://www.jiaokey.com/book/detail/96097012.html>)查找全本阅读方式

公差配合与技术测量评论地址<https://www.jiaokey.com/book/detail/96097012.html>

教客网提供千万本图书阅读地址。